

課題番号 : F-21-UT-0001
利用形態 : 技術補助
利用課題名(日本語) : ミリ波・マイクロ波計測
Program Title (English) : Millimeter-wave/Microwave measurement
利用者名(日本語) : 廣瀬明
Username (English) : A. Hirose
所属名(日本語) : 東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻
Affiliation (English) : Dept. of Electrical Eng. & Inform. Sys., The University of Tokyo
キーワード/Keyword : 切削、ミリ波・マイクロ波、導波路

1. 概要(Summary)

対象試料のミリ波・マイクロ波反射・透過特性を計測する際に不必要な散乱・反射を軽減するために、導波路の誘電率等の制御のためシリコン短冊をいくつか作製する。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

ステルスダイサー DISCO DFL-7340(Si 用)

【実験方法】

4インチの Si ウエハから、長さ 2, 4, 6, 8, 10, 30, 50, 70, 90 mm、幅 約 2 mm の短冊状チップ(各 4 本(長さ 10 mm のみ 8 本)の切り出しを行った。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

切り出した短冊状の Si チップの写真を Fig. 1 に示す。計画通りにダイスできた。

4. その他・特記事項(Others)

東京大学・微細加工プラットフォームの三角様にデザインのご指導をいただきました。

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

6. 関連特許(Patent)

なし。

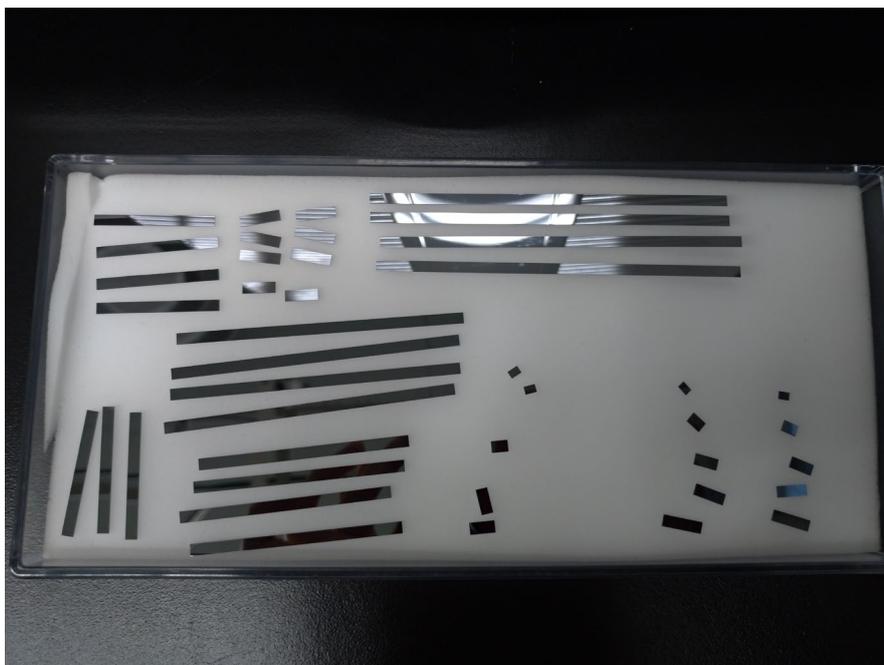


Fig. 1 Photograph of the diced Si chips with various sizes.